

证券代码：688375

证券简称：国博电子

南京国博电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	粤开证券、华泰证券、招商基金、化雨频沾私募、新华养老保险、太平资产、申量基金、建信养老、聚鸣投资、华泰资产、嘉瑞时序投资、创富兆业、中邮保险、华建投资
时间	2025年9月25日
地点	南京
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘洋 副总经理 李晓鹏 微系统事业部总经理 顾江川
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请公司介绍一下在特种领域各应用平台如机载、弹载、星载三个方向目前的进展情况如何？</p> <p>T/R 组件领域，公司凭借在微波毫米波设计领域的技术优势和制造工艺的长期积累，在各应用平台都取得相关进展。由于保密原因，有关 T/R 组件产品的具体信息不便披露。</p> <p>2、公司和五十五所的关系如何区分，是竞争关系还是合作关系？</p> <p>根据公司招股说明书披露，中国电科五十五所主要从事固态器件和微系统、光电显示与探测器件研发、生产和销售。其固态器件中的微波毫米波芯片和公司射频芯片存在一定的相似度。但中国电科五十五所主要从事微波毫米波芯片的设计和制造，产品主要用于特种行业市场，而国博电子主要从事射频芯片的设计，产品主要用于民用通信领域。二者在具体产品性</p>

能、形态、产业链环节、应用领域、主要客户等方面均存在较大差异，且双方的核心技术均来源于自身技术研发和积累、技术来源独立。因此不构成同业竞争。

此外，T/R 组件主要原材料为微波毫米波芯片，公司 T/R 组件产品的芯片制造主要依托于五十五所完成。

作为实际控制人，中国电科在公司上市时出具承诺函，以国博电子作为生产 T/R 组件产品并对外进行市场化销售的唯一上市平台，优先支持国博电子发展 T/R 组件业务，优先支持国博电子获得相关商业机会。

3、公司特种产品在“十四五”期间的降价幅度整体看有多少？未来的降价趋势怎么看？

公司长期以来一直合理定价，积极应对下游客户要求降价带来的压力，目前主流产品价格均处于较为稳定的状态，影响经营业绩的风险较小。

高质量、低成本、可持续一直是行业发展的大势所趋。公司在日常经营管理中注重成本管控，通过精益制造管理提升、工艺优化、自动化生产技术应用等措施来提高生产效率、降低成本，确保盈利能力和利润率保持稳定增长。

4、公司预计未来在“十五五”阶段，特种领域的产值规模能做到多少？

在相控阵雷达领域，信息化技术发展带来模式改变，信息化建设的重要程度日益彰显。相控阵雷达作为现代雷达技术的主流，其核心部件 T/R 组件的需求量持续攀升。公司紧跟行业发展趋势和重点预研动向，围绕用户需求进行产品策划，深度参与多个重点项目，积极开拓新的市场。

5、目前公司在组件领域的市场份额有没有什么变化？

根据公司披露的定期报告，公司研制了数百款有源相控阵 T/R 组件，产品市场占有率保持国内领先地位，除整机用户内部配套外，是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵 T/R

组件平台。

6、公司目前的产能规划及产能利用率水平如何？

过去一年，公司按计划推进射频集成电路产业园项目建设及募投项目实施，募投项目于 2025 年 3 月达到预计可使用状态，已完成结项。综合来看，公司目前产能利用率良好，公司在射频芯片、模块和 T/R 组件领域研发制造能力的规模化和智能化进一步提升，为未来“十五五”下游需求的增长做好充分准备。

7、公司在星网和 G60 低轨卫星项目的参与度如何？

公司在低轨卫星和商业航天领域均开展了技术研发和产品开发工作，多款 T/R 组件产品已交付客户。作为国内卫星载荷 T/R 组件和射频集成电路产品的主要供应商之一，公司与卫星载荷客户保持良好的合作关系，具体情况请关注公司后续披露的定期报告。

8、公司应用在卫星上的产品形态是什么？单星价值量有多少？

公司应用于星载领域的产品以有源相控阵 T/R 组件为主，还包括部分模块、芯片，在产业链中处于中上游的位置。2025 年，公司积极布局卫星领域业务方向，持续加大研发投入，不断提升产品的性能和质量以满足日益增长的市场需求。针对通信、遥感、导航等不同类型的卫星载荷，公司定制化研发相应产品，已形成批量供货。具体产品价格涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。

9、除了载荷之外，公司在卫星终端的布局有哪些？

当前，我国卫星互联网发展迈入高速期，各项星座建设加速启动，公司也谋定而动、乘势而上，高度重视并持续开展卫星领域产品研发和市场开拓。针对卫星通信领域，围绕星用、地面站和终端开展射频芯片、模组和收发阵列等系列产品的开发。

	<p>10、目前公司的手机直连卫星 PA 产品有何突破？</p> <p>公司重视并积极开拓手机直连卫星相关领域，多款产品正在开发，具体情况涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>11、公司应用于手机终端的 PA 新产品出货情况如何？售价是多少？</p> <p>公司研发的 PA 新产品已向客户批量供货。具体情况涉及商业秘密且未在披露范围内，请持续关注公司后续披露的相关公告。</p> <p>12、公司目前在一部手机的单机价值量能做到多少？</p> <p>目前，公司应用在手机终端的射频控制类芯片产品处于量产阶段，手机 PA 等新产品也开始向客户批量供货。后续将继续加大在射频控制类芯片和射频放大类芯片的研发力度，争取进一步扩大份额，提高单机价值量。</p> <p>13、公司应用在卫星领域的 T/R 组件产品是否采用 SIP 组件？</p> <p>在 T/R 组件领域，公司紧跟行业内先进封装技术发展趋势，积极开发应用 SIP 技术的相关产品，目前已形成批量供货。</p>
附件清单(如有)	无
是否涉及应当披露重大信息	否
日期	2025 年 9 月 26 日